

Raise3D Pro3 HS系列 技术规格

Raise3D Pro3 HS系列是一款功能强大的生产级设备，基于旗舰级Pro3系列的多维性能改进而设计。它在快速打印、高效生产和稳定可靠性方面表现出色。采用Hyper FFF®技术，可用于复合材料的高速打印。支持接力打印和2.5kg的材料兼容性，使制造商和3D打印农场主能够高效地生产小批量的终端零部件和工装夹具。

打印机	Raise3D Pro3 HS		Raise3D Pro3 Plus HS	
打印尺寸 (长×宽×高)	使用单喷头打印时	使用双喷头打印时	使用单喷头打印时	使用双喷头打印时
	300 × 300 × 300 mm	255 × 300 × 300 mm	300 × 300 × 605 mm	255 × 300 × 605 mm
机身尺寸 (长×宽×高)	620 × 626 × 760 mm		620 × 626 × 1105 mm	
重量	净重	毛重 (含包装带托盘)	净重	毛重 (含包装带托盘)
	54 kg	75.7 kg	64 kg	88.7 kg
电源	输入	通用100-240 VAC, 50/60 Hz 230 V @ 3.3A		
	输出	24 V DC, 600 W		
通用	技术原理	FFF熔丝制造技术		
	挤出系统	电动双喷头挤出系统		
	耗材直径	1.75 mm		
	XYZ轴步长精度	0.78125, 0.78125, 0.078125 micron		
	打印头移动速度	至高达1000 mm/s		
	打印速度	15-300 mm/s		
	打印平台	柔性底板、磁吸固定		
	打印平台最高温度	120°C		
	加热板材质	硅胶		
	打印底板校平	自动调平		
	接力打印	支持 (即将推出)		
	RFID 传感器	支持 (即将推出)		
	断料检测	支持		
	层厚	当前机器支持0.2, 0.4, 0.6, 0.8及1.0毫米的喷嘴口径, 层厚范围为0.05-0.6毫米。为实现稳定打印效果, 在使用0.4毫米喷嘴时, 我们推荐0.1至0.3毫米的层厚。		
	喷嘴直径	V3黄铜喷嘴0.4 mm (默认), 0.2/0.6/0.8/1.0 mm (可选)		
	喷嘴最高温度	320°C		
	连接	Wi-Fi, LAN, USB端口, 实时监控摄像头		
	噪音	< 55 dB(A)打印时		
	建议运行环境	15-30°C, 相对湿度10-90%, 无结露		
	存储温度	-25°C至+55°C, 相对湿度10-90%, 无结露		
	空气过滤器	HEPA空气滤净系统		
	EVE智能助手	支持		
材料	支持材料	Hyper Core 速聚芯™ 系列: PPA CF/ PPA GF/ ABS CF Hyper Speed系列: PLA/ ABS Industrial系列: PPA CF/ PPA GF/ PET CF/ PET GF/ PETG ESD/ PET Support/ PPA Support Premium系列: PLA/ ABS/ ASA/ PETG/ PC/ TPU-95A/ PVA+		
	第三方材料	由Raise3D OFP (开放式耗材项目) 支持*		
软件	切片软件	ideaMaker		
	输入文件格式	STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP/ STEP/ STP/ IGES/ IGS		
	操作系统	Windows/ macOS/ Linux		
	输出文件格式	GCODE		
打印机控制	用户界面	7英寸触摸屏		
	网络连接	Wi-Fi, 以太网		
	断电续打功能	支持		
	屏幕分辨率	1024×600		
	运动主控芯片	Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU		
	逻辑控制芯片	NXP ARM Cortex-A9 Quad 1GHz		
	内存	1 GB		
	闪存	16 GB		
	操作系统	嵌入式Linux		
接口	USB 2.0×2, 以太网×1			

*请访问<https://www.raise3d.cn/ofp-filaments/>, 获取相关信息以及Raise3D OFP项目支持的耗材打印模板